

2026年2月4日

2025年度 3Q 業績説明会 Q&A

No.1	Q. 再修正計画(2月)におけるSiCの品質保証費用、材料コストの上昇、評価減の金額内訳は。
	A. 品質保証費用は3Qに42億円を計上し、4Qに20億円を計上予定。評価減は特定のSiC基板について4Qに17億円を計上予定。また、その他評価減を4Qに26億円見込んでいる。これらの要素は一過性であり、特に計62億円の品質保証費用は今後発生しない見込み。材料コストの追加的なマイナス影響はない。
No.2	Q. 下期にSiC関連の品質保証費用が集中して計上された原因は何か。
	A. 車載インバータ向けビジネスが急拡大する中で、量産開始前後に顧客の要求仕様に合わせて調整する必要が生じ、追加的にコストが発生した。
No.3	Q. 品質保証費用が発生したSiCデバイスは第4世代がメインか。
	A. 問題が発生したのは6インチ基板で製造した第4世代のデバイスだが、デバイスの品質に問題はない。
No.4	Q. SiCの品質保証費用はどの地域の顧客で発生したか。また、今後も発生しうるか。
	A. 今回の問題は、車載インバータの採用が拡大している欧州、中国で発生した。歩留まりの高い第5世代・8インチへ移行すること、今回の経験を踏まえた保証体制を構築したことから、問題は一過性のものとして今期で終わると見込んでいる。
No.5	Q. SiC基板の外販ビジネスが大きく調整された背景と来期の見通しはどうか。
	A. 顧客の在庫調整による受注キャンセルが原因。ただし、前受金として受け取っていたキャッシュの返還は不要で売上同等の利益は確保している。来期も外販再開の見込みはなく、独SiCrystalは自社向けの8インチ基板の生産に注力する計画。
No.6	Q. SiC事業の来期売上は中期経営計画に対してダウンサイドリスクがあるか。
	A. SiC基板の外販がなくとも、欧州向け車載ビジネスを中心にSiCデバイスの販売が好調であり、来期のSiC事業の売上は今期比で30~40%増加すると予測している。SiC基板の外販調整に伴うダウンサイドリスクは相殺できる見込み。
No.7	Q. トップライン見通しについて、メモリ不足などによるリスクや市況感はどうか。
	A. カメラや車載のナビ・オーディオ向けメモリ不足のリスクがあり、車載比率が50%である当社にとって大きな影響となる可能性がある。一方、AIサーバー向けは好調で、2030年には売上が500億円規模まで伸びる可能性が見え始めており、計画を上回る見込みである。
No.8	Q. 金の価格高騰に伴うコスト増に対し、値上げによってどの程度の効果が来期に見込めるか。
	A. 値上げ交渉では、7割の顧客と合意しており、来期には50億円程度を回収できる見込み。足元ではさらに金が値上がりしているが、値上げ交渉を重ねるよりも、金から銅への材料置換えを推進している。
No.9	Q. 東芝との協議の進捗は。中期経営計画における工場再編への影響と今後のタイムラインはどうか。
	A. 東芝との協議は最終局面にあるが、急ぐあまり不利な条件を飲むことはしない。機会損失を防ぐためにも東芝との協議は本決算までには結論を出したい。現状はスタンドアローンで実行できる範囲で計画を進めており、6インチラインから8インチラインへの転換など、国内・海外とともに再編計画は進展している。